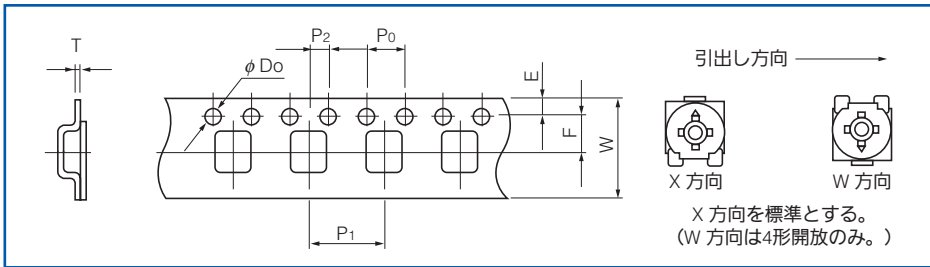


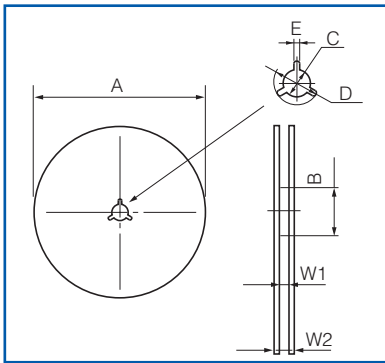
チップ半固定ボリューム包装方法

● エンボスキャリアテーピング



製品形状		テープ幅	W	F	E	P ₁	P ₂	P ₀	φD ₀	T
サーメット系	2形開放	8 mm	8	3.5	1.75	4	2	4	1.5	0.6 max.
	3形開放	幅テープ								
	4形開放	12 mm 幅テープ				8				

● テーピング用リール

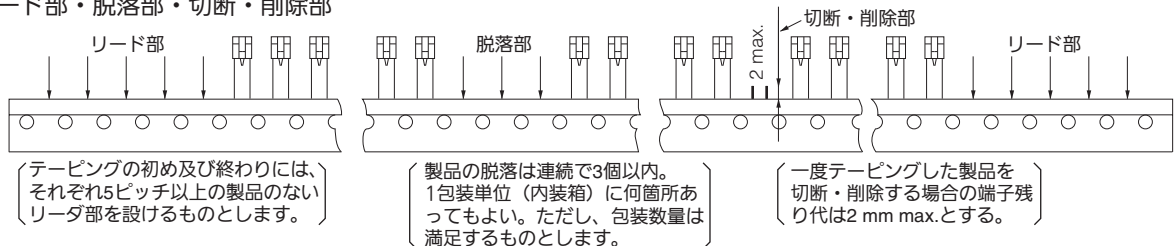


製品形状		テープ幅	A	W1	W2	B	C	D	E
			±2	+2 0	max.	min.	±0.2	±0.8	±0.5
サーメット系	2形開放	8 mm	φ178	8.4	14.4	φ60	13	21	2
	3形開放	幅テープ							
	4形開放	12 mm 幅テープ							

セラミック半固定ボリューム包装方法

● テーピング状態

1. リード部・脱落部・切断・削除部



2. 引張り強度

- ・ 製品をA方向に4.9 Nで引張った時、製品の抜け、外れが無きこと。
- ・ 製品をB方向に0.98 Nで3秒間引張った時、製品の外れが無きこと。

